



英特尔晶圆代工业务宣布在**14**纳米制程技术上推出领先业界的**32 Gbps**串行解串器

运行范围扩大到**1**至**32 Gbps**进一步提升在功耗、性能和面积上的领先性

新闻要点

- 基于之前已经开发于**14**纳米制程上的具有功耗、性能、面积的领先性的**1**至**16 Gbps GP**串行解串器
- 运行范围扩大到**1**至**32 Gbps**，同时全面支持**28 Gbps**常见通用电气接口（**CEI**）长距离规范
- 为有着业内最广泛的速率范围的串行解串器标准提供了极佳的灵活性和可编程性

2014年12月1日，北京——英特尔公司近日公布在**14**纳米制程上的**1**至**32 Gbps**高速串行解串器（**SerDes**）硅片特性。以先前推出的**1**至**16 Gbps GP 14**纳米串行解串器为基础，新增**32 Gbps**串行解串器是第二款产品，预计于今年年底上市。

英特尔的**14**纳米串行解串器系列为第二代产品，延续了基于英特尔**22**纳米三栅极制程技术的第一代**12**和**28 Gbps**串行解串器的成功。与英特尔的**22**纳米串行解串器相比，新的**14**纳米串行解串器扩大了运行范围，同时降低功耗达**20%**，芯片面积减少了超过**40%**。

此次宣布为晶圆代工业界首次在**20**纳米以下制程技术上推出**32 Gbps**多标准串行解串器。

英特尔晶圆代工业务设计与支持服务副总裁**Ali Farhang**表示：“英特尔的串行解串器架构持续地随着每一代三栅极制程的进步而改良。我们能满足**28G CEI LR**规范，同时支持低至**1Gbps**的运作，从而为客户的产品设计提供灵活性。”

1至**32 Gbps**串行解串器涉及的标准极为广泛，例如**USB**、**PCIe**、以太网和**10G-KR**，以极低的抖动性保持功耗和面积效率，并将其高效率表现扩展到了**OIF**、**100G**以太网和**32**光纤通道等新标准。英特尔的串行解串器为一个完整的产品，以广泛的集成、测试和验证资料，提供具方向性的灵活度和标准配置能力，从而帮助客户轻松实现集成。

Achronix首席执行官**Robert Blake**表示：“针对高性能的**Achronix FPGA**，我们评估了很多串行解串器供应商。采用英特尔**22**纳米的**12.75G**串行解串器和采用英特尔**14**纳米的**32G**串行解串器皆能满足我们对功耗和性能的严格要求，同时能提供我们所需的广泛功能。英特尔晶圆代工业务的串行解串器是我公司**FPGA**产品所需的关键性的竞争优势，符合我们对于高速接口更加广泛的需求。”

英特尔（纳斯达克：INTC）是计算创新领域的全球领先厂商。英特尔设计和构建关键技术，为全球的计算设备奠定基础。作为企业责任和可持续发展的领导者，英特尔制造了世界上首款商用“无冲突”微处理器。了解有关英特尔的更多信息，请访问：www.intel.com/cn 新闻发布室及blogs.intel.com/china/，关于英特尔在“无冲突”上做出的努力，请访问conflictfree.intel.com

英特尔、Intel 标识和英特尔酷睿是英特尔公司在美国和其他国家（地区）的商标。

* 文中涉及的其他名称及商标属于各自所有者资产。